

<p>(51) 国際特許分類6 C09J 9/02, H21L 21/60</p>	<p>A1</p>	<p>(11) 国際公開番号 WO00/09623</p> <p>(43) 国際公開日 2000年2月24日(24.02.00)</p>
<p>(21) 国際出願番号 PCT/JP98/03609</p> <p>(22) 国際出願日 1998年8月13日(13.08.98)</p> <p>(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) 日立化成工業株式会社 (HITACHI CHEMICAL COMPANY, LTD.)[JP/JP] 〒163-0449 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号 Tokyo, (JP)</p> <p>(72) 発明者 ; および (75) 発明者 / 出願人 (米国についてののみ) 渡辺伊津夫(WATANABE, Itsuo)[JP/JP] 〒308-0842 茨城県下館市一本松1194-6 Ibaraki, (JP) 竹村賢三(TAKEMURA, Kenzo)[JP/JP] 〒307-0001 茨城県結城市結城8237-1 Ibaraki, (JP) 永井 朗(NAGAI, Akira)[JP/JP] 〒305-0035 茨城県つくば市松代3-4-1 日立化成松代ハウスB306 Ibaraki, (JP) 井坂和博(ISAKA, Kazuhiro)[JP/JP] 渡辺 治(WATANABE, Osamu)[JP/JP] 小島和良(KOJIMA, Kazuyoshi)[JP/JP] 〒300-3261 茨城県つくば市花畑1-15-18 紫峰寮 Ibaraki, (JP)</p>		<p>(74) 代理人 弁理士 富田和子, 外(TOMITA, Kazuko et al.) 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2丁目9-10 横浜HSビル7階 Kanagawa, (JP)</p> <p>(81) 指定国 AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GE, GH, GM, HU, ID, IL, IS, JP, KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZW, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), ARIPO特許 (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SZ, UG, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM)</p> <p>添付公開書類 国際調査報告書</p>
<p>(54)Title: <u>ADHESIVE FOR BONDING CIRCUIT MEMBERS, CIRCUIT BOARD, AND METHOD OF PRODUCING THE SAME</u></p>		
<p>(54)発明の名称 回路部材接続用接着剤並びに回路板及びその製造方法</p>		
<p>(57) Abstract An adhesive for bonding and securing a semiconductor chip to a circuit board and electrically connecting the electrodes of the two, and containing 100 parts by weight of an adhesive resin composition and 10 to 200 parts by weight of an adhesive resin composition and 10 to 200 parts by weight of an inorganic filler; a circuit board in which the circuit members are bonded together with the adhesive, and a method of producing the circuit board.</p>		